



关于上海季丰电子股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市的
审核中心意见落实函的回复

保荐人（主承销商）



光大证券股份有限公司
EVERBRIGHT SECURITIES CO., LTD.

（上海市静安区新闻路 1508 号）

深圳证券交易所：

根据贵所于 2026 年 9 月 24 日下发的《关于上海季丰电子股份有限公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的审核中心意见落实函》（审核函〔2026〕010180 号）（以下简称“落实函”）的要求，上海季丰电子股份有限公司（以下简称“季丰电子”、“发行人”、“公司”）会同光大证券股份有限公司（以下简称“保荐人”、“光大证券”），本着勤勉尽责、诚实守信的原则，对落实函提出的问题逐项进行了认真核查落实，现回复如下，请予审核。

如无特别说明，本回复中的简称或名词释义与《上海季丰电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿）》中释义相同。

本回复中的字体代表以下含义：

审核中心意见落实函所列问题	黑体（加粗）
审核中心意见落实函所列问题的回复	宋体
回复中涉及对招股说明书修改、补充的内容	楷体（加粗）

本回复中若部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，均由四舍五入造成。

目录

问题 1. 关于业务稳定性和成长性	3
-------------------------	---

问题 1. 关于业务稳定性和成长性

申报材料及问询回复显示：

（1） 发行人所处的半导体行业具有较强的周期性特征，受全球宏观经济、国际贸易环境、下游终端市场需求等多重因素影响。近年来，随着人工智能、物联网、汽车电子等新兴领域的快速发展，半导体市场需求持续增长。

（2） 2026 年 1-6 月，发行人净利润同比下滑，变动趋势因业务结构及所处发展阶段，与部分同行业可比公司存在差异。

请发行人披露：

（1） 结合全球及境内半导体行业的历史周期波动特征、当前所处的周期阶段以及本轮周期的未来走势，说明发行人报告期内业绩快速增长的主要驱动因素，与下游半导体行业景气度之间的关系，下游行业进入下行周期对发行人业务稳定性的具体影响。

（2） 结合发行人期后在手订单执行及客户需求变动情况，分析客户自建实验室是否会对发行人订单的持续性 & 经营业绩产生重大不利影响，是否存在经营业绩不及预期的风险，进一步完善招股说明书相关风险提示的内容。

请保荐人简要概括核查过程，并发表明确核查意见。

【回复】

一、发行人披露

（一） 结合全球及境内半导体行业的历史周期波动特征、当前所处的周期阶段以及本轮周期的未来走势，说明发行人报告期内业绩快速增长的主要驱动因素，与下游半导体行业景气度之间的关系，下游行业进入下行周期对发行人业务稳定性的具体影响

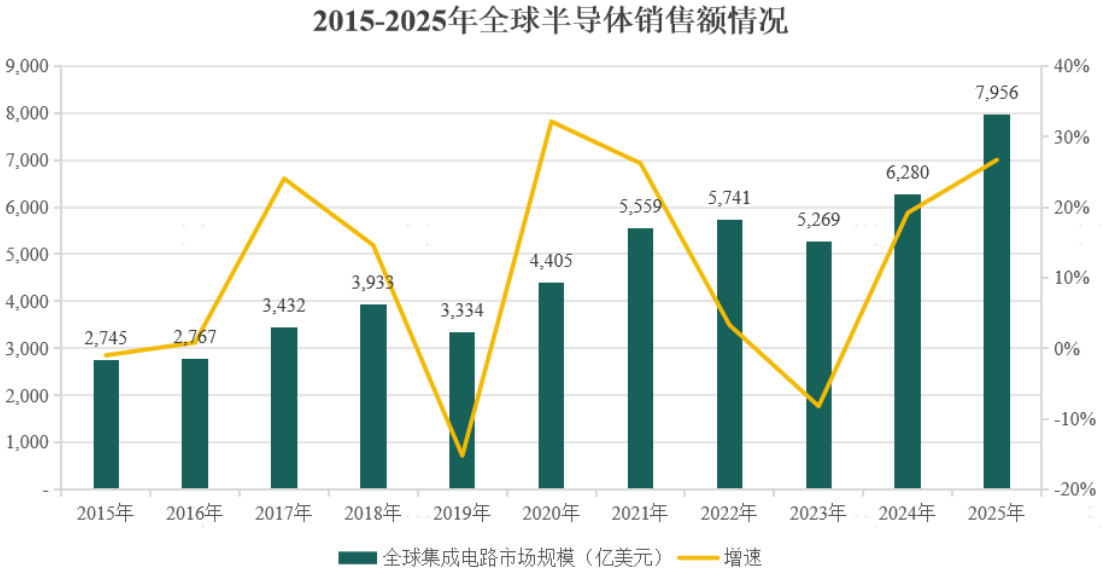
全球及中国境内半导体行业具备周期波动特征，当前均处于由 AI 算力驱动的上行周期。报告期内，发行人业绩快速增长，系全球及中国境内半导体产业扩容、国产替代加速带来的行业红利，叠加公司客户拓展、多地实验室产能释放、

一站式业务体系完善等内外部因素共同驱动。公司业绩与下游行业景气度存在相关性，但并非简单线性同步，发行人主营的第三方实验室检测分析、集成电路测试板业务以客户研发验证需求为核心，呈现一定弱周期性特征。若行业进入下行周期，发行人不同业务板块将呈现结构性分化特征，依托多元化客户结构、多区域实验室布局及一站式综合业务体系，公司具备良好的周期对冲能力与风险抵御能力，整体业务具备较强的稳定性与成长性。

1、全球及境内半导体行业的历史周期波动特征、当前所处的周期阶段以及本轮周期的未来走势

（1）全球半导体行业的历史周期波动特征、当前所处的周期阶段以及本轮周期的未来走势

从历史发展趋势来看，全球半导体行业整体呈现波动中向上的长期发展态势。历史上前几轮行业上行主要由个人计算机、智能手机等标志性终端应用驱动，但由于晶圆制造产能建设存在 1-2 年的传导滞后，行业厂商基于当期市场景气开展扩产，待产能释放后易与实际终端需求形成错配，叠加产业链渠道环节补库存、去库存带来的库存周期，由此形成 4-5 年左右一轮的行业波动循环。在需求上行阶段，行业资本开支扩张、产品价格抬升；需求回落阶段，则进入去库存调整，产品价格承压，行业规模阶段性回落。整体而言，行业在多轮周期交替的过程中实现长期规模增长。2015 年以来，全球半导体行业销售额情况具体如下：



数据来源：WSTS

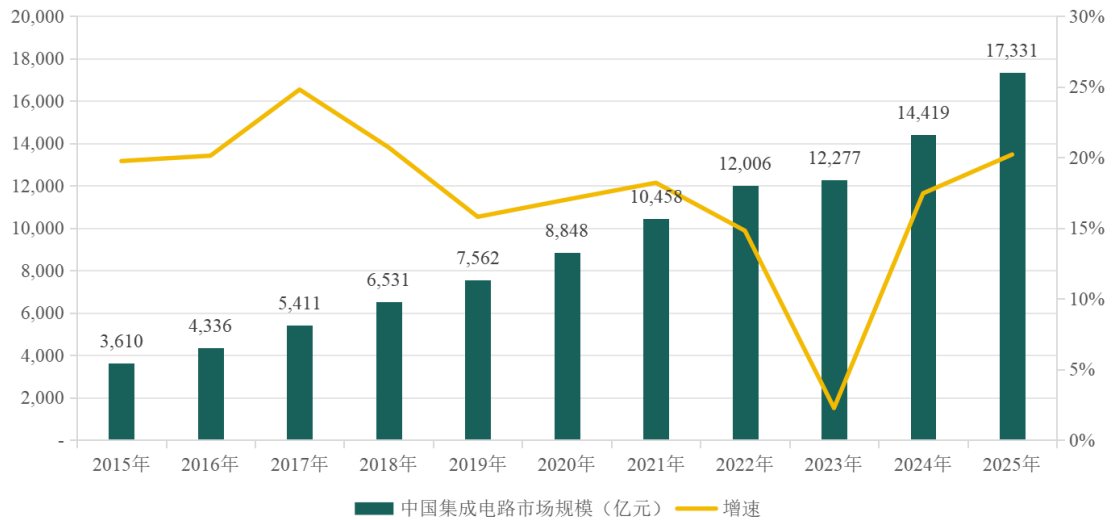
当前，全球半导体行业处于由 AI 算力驱动的上行周期，AI 算力芯片、HBM 高带宽存储，以及先进制程、先进封装相关领域成为本轮周期的核心增长赛道，智能驾驶、人形机器人等新兴应用共同构成需求增量。根据 WSTS 在 2026 年 5 月更新的预测，2026 年全球半导体市场规模将增长 90%，达到 1.51 万亿美元，2027 年将在此基础上再增长 27%，约达 1.9 万亿美元。本轮周期不同于过往个人计算机、手机时代全产业链普涨的特征，呈现显著结构性景气特征，AI 相关产业链条实现高速扩张，带动全球芯片设计、晶圆制造、半导体设备、封装测试环节的投资与产出持续提升。

未来，半导体行业仍将延续周期波动特征，但本轮 AI 驱动下技术带来的增量空间充足，预计未来半导体产业体量将显著高于历史周期水平。

（2）境内半导体行业的历史周期波动特征、当前所处的周期阶段以及本轮周期的未来走势

我国境内集成电路产业整体保持稳步增长态势，行业营收规模持续扩张，未出现全球市场曾发生的销售额绝对值下滑情形，行业周期主要体现为增速的起伏波动。我国境内集成电路产业景气度会受到全球半导体周期的传导影响，但叠加独立的国产替代成长红利。一方面，全球供需、价格、库存的变化会通过下游终端订单、芯片采购等渠道向国内产业链传导；另一方面，2018 年以来，我国境内自主可控与供应链安全催生独立需求增量，13 家龙头企业在 2026 年 3 月上海 Semicon China 展会联合发布的路线图明确，到 2030 年，中国芯片自给率将从当前的 33% 跃升至 80%，同步实现 14nm 芯片稳定量产、7nm 全国产设备产线测试，在我国芯片自给率跃升的过程中，境内集成电路产业具备长期成长逻辑，产业发展红利将持续释放，即便在全球行业下行周期中，境内企业也能持续获得订单，弱化行业下行幅度。

2015-2025年中国集成电路行业市场规模情况



数据来源：中国半导体行业协会

当前，我国境内集成电路产业同样处于 AI 算力驱动的上行周期。境内 AI 算力基础设施建设、智能驾驶、人形机器人等新兴领域需求持续扩容，算力芯片、HBM、先进制程与先进封装等赛道供需紧张，在 AI 相关产品供不应求与半导体领域出口管制的双重外部背景下，境内半导体产业链迎来技术验证与产品导入的良好机遇，国产替代进程与 AI 产业需求形成共振，带动产业链各环节订单落地、产能建设持续推进。

中长期，预计我国境内集成电路产业销售额仍将维持增长态势，但增速仍会存在周期性波动；与全球市场类似，即便后续出现波动，产业整体发展基础与体量也较历史阶段已实现较大提升。

2、发行人报告期内业绩快速增长的主要驱动因素，与下游半导体行业景气度之间的关系，下游行业进入下行周期对发行人业务稳定性的具体影响

（1）发行人报告期内业绩快速增长的主要驱动因素

报告期内，公司营业收入分别为 44,336.65 万元、58,348.29 万元、66,949.34 万元及 37,885.76 万元，2023 至 2025 年度营业收入复合增长率为 22.88%。报告期内，发行人业绩快速增长的主要驱动因素如下：

①外部环境：中国境内半导体第三方检测分析市场扩容，行业竞争格局向本土头部机构倾斜

一方面，中国境内半导体第三方实验室检测分析行业随着境内半导体产业发展持续扩容。根据中国半导体行业协会统计，中国境内集成电路行业市场规模由 2021 年 10,458 亿元增长至 2025 年 17,331 亿元，年复合增长率达 13.46%。中国境内集成电路产业自主发展进程持续推进，产业链研发、量产环节相应的失效分析、可靠性测试等检测分析需求稳步释放；叠加汽车电子、人工智能等下游应用领域不断提升对芯片品质与可靠性的要求；同时，行业持续攻坚先进制程、先进封装技术，制造工艺复杂程度持续走高，相较于成熟制程，28nm 及以下先进制程工艺研发阶段的材料分析、良率分析需求呈指数级增长。根据集微咨询统计，中国境内半导体第三方实验室检测市场规模由 2021 年 81.2 亿元增长至 2025 年 125.5 亿元，行业保持稳定增长态势。

另一方面，受益于市场竞争格局变化，本土专业市场化机构市场集中度提升。其一，中国境内半导体产业链自主可控进程持续推进，晶圆厂、芯片设计企业出于供应链安全、工艺数据保密及合规管控需求，一定程度上减少与非本土检测机构的合作，中国台湾第三方实验室宜特、闳康先后出售中国境内半导体检测分析业务的控制权；其二，在中国境内，高端产能与订单向本土头部实验室集中，半导体第三方实验室检测分析业务具有明显的设备、人才密集型特征，当前我国境内半导体产业持续向先进制程、先进封装迭代，汽车电子等下游应用对芯片品质与可靠性管控标准持续提升，下游客户对应的实验室检测需求日趋专业化、复杂化，因此下游头部晶圆厂、芯片设计企业会优先选择具备复杂工艺缺陷解析能力、配备全套高端检测仪器设备、拥有全国多点快速响应服务能力、长期市场口碑稳定合规的头部实验室。

②内部因素：客户量质齐升、区域实验室产能释放及一站式布局贡献增量

报告期内，发行人客户数量与收入贡献同步增长、多地实验室产能逐步释放、一站式业务布局落地，多重内部因素共同推动经营业绩快速提升，具体如下：

其一，客户数量与收入贡献同步增长。从客户数量来看，2023 年、2024 年、2025 年，发行人客户数量分别为 1,247 家、1,537 家、1,724 家，保持较快增长。从客户收入贡献来看，一方面发行人新增晶圆厂、设备厂等高价值客户，如客户 A、客户 K、客户 B 等；另一方面原有芯片设计公司、晶圆厂客户与发行人的合

作深度持续提升、收入贡献稳步增加，如客户 D、兆易创新科技集团股份有限公司、恒玄科技（上海）股份有限公司、杰华特微电子股份有限公司、客户 C 等。

其二，发行人在半导体产业集聚地布局的实验室收入逐步增长。为就近服务半导体产业链重点区域的客户群体，发行人自 2021 年起在北京、深圳、杭州、成都等地布局实验室，配置专业技术团队与检测仪器设备，相关前期投入的效益在报告期内逐步释放。北京亦庄实验室 2024 年开业，2024 年、2025 年、2026 年 1-6 月，营业收入（单体报表口径）分别为 7,381.61 万元、9,014.41 万元、4,598.87 万元；报告期内，深圳实验室营业收入（单体报表口径）分别为 2,704.24 万元、3,255.32 万元、4,347.67 万元及 1,845.45 万元。此外，北京海淀实验室、成都实验室的营业收入均在报告期内实现增长。

其三，发行人围绕半导体产业链检测需求打造的一站式业务布局为公司业绩贡献增量。集成电路测试板等检测硬件产品作为公司核心业务之一，受益于下游客户需求增长与公司市场竞争力提升，报告期内，检测硬件产品收入分别为 11,437.15 万元、12,473.52 万元、15,333.34 万元及 8,561.62 万元，保持稳步增长。基于积累的技术能力与客户资源，公司于 2022 年拓展了量产测试业务，重点布局前景广阔、技术壁垒较高的车规级芯片量产测试市场；为了匹配主业客户群体“芯片-模组”产业链延伸配套服务、仪器设备电路板配套业务等需求，公司在原服务于内部集成电路测试板业务而布局的表面贴装线基础之上，于 2025 年新设浙江嘉善产线规模化投入电子制造服务业务，这两类业务收入在报告期内亦实现增长。

（2）与下游半导体行业景气度之间的关系

发行人业绩增长是行业景气红利叠加自身客户拓展、区域实验室投产、一站式业务布局等内部能力建设共同作用的结果，并非单纯跟随行业景气度被动增长。发行人报告期内业绩增长与下游半导体行业景气度存在相关性，但并非简单的线性同步关系，具体如下：

一方面，全球及中国境内半导体产业持续增长构成公司业务的底层市场基础。根据 WSTS 预测，2026 年全球半导体市场规模将达到 1.51 万亿美元。中国境内市场受益于国产替代加速、供应链自主可控战略推进，产业增长的确定性和韧性

相对更强，为第三方实验室检测分析、集成电路测试板、量产测试等业务提供稳定的市场基础。与此同时，先进制程、先进封装技术持续迭代带来工艺复杂度显著提升；叠加人工智能、汽车电子等应用场景对芯片性能、功耗、可靠性及安全性提出更为严苛的管控标准，持续催生验证测试、失效分析、配套硬件及量产测试需求，为发行人相关业务发展创造良好的市场环境。

另一方面，第三方实验室检测分析业务、集成电路测试板业务需求的核心驱动力主要是下游客户的研发活动，行业呈现一定的弱周期性特征。当行业进入调整下行阶段，市场竞争加剧将倒逼半导体企业持续开展研发创新与工艺良率优化，失效分析、材料表征等研发配套检测需求，以及作为芯片研发评估关键硬件接口的测试板产品需求，能够保持稳定甚至实现逆势增长；就第三方实验室检测分析业务而言，行业下行周期中，下游企业出于成本管控考量，倾向缩减自建实验室资本开支，将检测分析工作外包至专业第三方机构，进一步支撑第三方检测服务需求。但是，如果行业出现深度、长周期下行，下游客户大幅压缩研发预算，行业需求仍将承压。

半导体行业最近一轮周期以 2021 年为高点，2022 年、2023 年行业进入下行阶段，自 2024 年起逐步修复上行。在本轮周期波动过程中，发行人及同行业公司基本实现稳步增长，体现出发行人及同行业公司业绩并非单纯被动跟随行业景气度波动，具体情况如下：

单位：万元

公司名称	2022 年度		2023 年度		2024 年度		2025 年度	
	营业收入	增长率	营业收入	增长率	营业收入	增长率	营业收入	增长率
闾康	89,136.55	18.24%	106,942.79	19.98%	112,265.58	4.98%	124,791.86	11.16%
胜科纳米	28,720.92	71.39%	39,398.33	37.18%	41,527.19	5.40%	52,952.73	27.51%
苏试宜特	29,964.71	13.83%	28,093.20	-6.25%	32,022.67	13.99%	39,070.17	22.01%
雍智科技	34,300.63	3.21%	30,878.52	-9.98%	39,380.39	27.53%	47,757.71	21.27%
伟测科技	73,302.33	48.64%	73,652.48	0.48%	107,686.99	46.21%	157,464.24	46.22%
发行人	28,899.51	111.96%	44,336.65	53.42%	58,348.29	31.60%	66,949.34	14.74%

注：苏试宜特系上市公司苏试试验（300416.SZ）控股子公司，其营业收入为苏试试验在各年年报中披露的苏试宜特（上海）检测技术股份有限公司的相应数据。

(3) 下游行业进入下行周期对发行人业务稳定性的具体影响

若下游半导体行业进入下行周期，对发行人业务将形成结构性、差异化影响，不同业务板块抗波动能力存在差异：

①量产测试业务、用于量产测试环节中的集成电路测试板产品系与客户产线稼动率强相关的业务，受行业下行冲击相对更明显。行业下行阶段，晶圆厂、芯片设计企业通常压缩资本开支、下调产能利用率、控制新增量产订单，芯片出货量下滑会使得该类业务订单增速放缓甚至阶段性回落。

②第三方实验室检测分析业务、用于研发验证环节中的集成电路测试板产品与客户研发投入、技术迭代更为相关，抗周期能力更强。行业下行阶段，下游客户为迭代产品、改善良率与工艺，仍需维持较多的研发验证投入；叠加国内产业链自主可控、先进技术攻关的长期方向不变，该部分需求具备一定刚性。

③多元化客户结构、多区域实验室布局及一站式业务布局能够缓冲周期冲击。报告期内，发行人客户覆盖晶圆制造、芯片设计、封装测试、半导体设备与材料等多类主体，下游客户的终端市场覆盖汽车电子、工业控制、AI、消费电子等多个赛道，单一终端需求波动对整体业务冲击有限；全国多点实验室就近服务、一站式业务模式，有助于提升客户粘性，在行业下行阶段巩固存量市场份额，有效降低公司整体经营业绩的周期性波动幅度，增强公司业务经营的稳定性与抗风险能力。

综上，尽管半导体行业存在周期波动特征，但当前中国境内半导体产业长期国产替代、先进技术迭代的大方向未发生改变，短期行业景气波动不会改变研发验证类检测及配套硬件业务的底层需求逻辑。发行人报告期业绩增长是行业发展机遇叠加自身经营能力建设共同作用的结果，业绩与下游景气度相关但并非单纯跟随行业景气度被动增长。在行业下行阶段，公司第三方实验室检测分析业务与用于研发验证环节的集成电路测试板产品韧性更强，量产测试等与产线稼动强相关业务承压相对明显，依托多元客户、区域实验室布局及一站式业务体系可部分对冲周期冲击。整体而言，公司业务具备较强的稳定性与成长性。

（二）结合发行人期后在手订单执行及客户需求变动情况，分析客户自建实验室是否会对发行人订单的持续性 & 经营业绩产生重大不利影响，是否存在经营业绩不及预期的风险，进一步完善招股说明书相关风险提示的内容

1、发行人期后在手订单执行及客户需求变动情况

(1) 发行人期后在手订单执行情况

截至 2026 年 6 月 30 日，发行人第三方实验室检测分析业务的在手订单金额为 8,513.53 万元。

截至 2026 年 8 月 31 日，2026 年 6 月 30 日第三方实验室检测分析业务在手订单已履行完毕转化为收入的金额为 6,720.77 万元，已执行完毕待客户确认的金额为 1,783.26 万元，在手订单转化率为 99.89%，在手订单执行情况良好。

截至 2026 年 8 月 31 日，发行人第三方实验室检测分析业务的在手订单金额为 9,197.30 万元。2026 年 6 月末在手订单已基本执行完毕，在此基础上公司持续获取新订单，使得 8 月末在手订单规模保持增长。

(2) 客户需求变动情况

①发行人客户数量多、需求相对分散，客户需求稳中有升

报告期内，发行人第三方实验室检测分析业务收入分别为 27,760.40 万元、37,862.80 万元、42,437.31 万元及 23,002.57 万元，2023 年至 2025 年复合增长率为 23.64%，成长性较强，收入增长主要系下游客户检测分析需求持续扩容所致，反映客户对第三方实验室检测分析服务的需求稳步提升。

报告期各期，发行人第三方实验室检测分析业务的客户数量均超过 1,000 家，呈现客户数量多、需求相对分散的特征，客户结构与半导体产业链各环节分布特点相匹配，客户群体数量与需求保持稳中有升态势。其中客户群体以芯片设计企业为主；晶圆厂客户分布相对集中，基于工艺开发、产线良率提升产生大量材料分析需求，单个客户采购金额较高。随着半导体设备国产替代进程持续推进，设备厂商在研发验证环节对第三方实验室检测分析的需求快速增长，2026 年 1-6 月，公司新增客户 K 等半导体设备厂商作为主要客户。

②下游半导体产业链对第三方实验室检测分析服务的需求持续增长

在半导体国产替代加速推进、先进制程与高可靠应用持续演进、海外技术管制的大背景下，芯片设计、晶圆制造、半导体设备、材料及封测等产业链各环节

企业，基于新品研发迭代、工艺良率改善、前沿技术验证、严苛标准合规认证等多重诉求，对第三方实验室检测分析服务需求持续增长。根据集微咨询统计，2025 年我国境内半导体第三方实验室检测分析市场规模将达到约 125.5 亿元，预计到 2027 年有望达到 181.5 亿元，年复合增长率为 20.3%。

①芯片设计企业

对芯片设计企业而言，其对第三方实验室的检测需求贯穿研发、工程批及量产全流程，其中研发阶段为核心需求来源，研发与工程批阶段需求由企业新品规划、新增研发项目数量决定，量产阶段需求则主要受下游终端品质要求提升驱动，包括常态化可靠性测试、客诉品失效分析等。芯片设计企业对第三方检测分析服务的需求变化主要体现在以下方面：第一，人工智能、光电、存储等新兴赛道产品快速迭代，企业持续加码技术研发、新增研发项目数量不断增多，带动前端研发与工程验证类检测需求快速增长；第二，芯片设计企业逐步采用先进制程、先进封装等技术方案，相关检测分析复杂度大幅提升，对实验室高端仪器配置、复杂缺陷根因解析的专业能力提出更高要求；第三，汽车电子等高可靠性应用对芯片使用寿命、失效判定阈值设置更为严苛，倒逼企业扩充检测验证项目，进一步增加检测服务需求。随着我国半导体产业国产替代进程持续推进，部分中高端检测订单逐步由外资、台资检测机构转向具备综合服务能力的本土第三方实验室。

细分来看，人工智能芯片行业高速发展持续拉动高端检测分析需求，根据弗若斯特沙利文预测，中国人工智能芯片市场规模将由 2024 年的 1,425 亿元增至 2029 年的 1.3 万亿元，2025-2029 年复合增速高达 54%；车规级芯片受益于汽车电动化、智能化双轮驱动，单车芯片搭载数量与单芯片价值持续抬升，检测可靠性、精准度要求大幅提高，据中汽协及易车研究院统计，2024 年传统燃油车单车芯片数量约 1,000-1,100 颗，新能源汽车单车芯片搭载量达 1,700-1,900 颗，预计 2025-2026 年传统燃油车单车芯片数量将提升至 1,200-1,400 颗，新能源汽车单车芯片数量将达到 2,000-2,400 颗，单车芯片用量的持续增长直接带动芯片检测分析需求持续放量。

②晶圆制造企业

对晶圆制造企业而言，第三方实验室检测分析需求主要集中于新工艺研发、

产线良率爬坡、成熟量产质控三大核心阶段。具体来看，在工艺研发阶段，晶圆制程从成熟制程向先进节点阶梯式迭代，工艺流程复杂度、工序数量大幅提升，几乎每一道或间隔数道工序的晶圆半成品，都需要通过材料分析核验薄膜厚度、元素组成、界面形貌、掺杂浓度等核心参数，保障工艺设计落地；在产线良率爬坡阶段，新建产线初始良率往往较低，良率提升是产线实现商业化落地、形成成本竞争力的核心关键，且先进制程良率优化周期长、攻坚难度大，需要长期持续的缺陷分析与工艺调试，这一过程中会产生大量失效分析需求，在常规失效分析无法定位深层缺陷时，还必须借助 TEM 等高端微观分析设备，从材料微观结构挖掘失效根因、解析失效模式；在成熟量产阶段，产线核心需求转为常态化质量监控，针对异常批次开展针对性失效分析，保障量产稳定性。

晶圆制造企业对第三方实验室检测分析的需求持续增长，是行业技术迭代、产能运营模式、成本管控与供应链安全多重因素共同驱动的结果。其一，先进制程持续迭代催生增量检测需求，现阶段国内大多数晶圆制造企业逐步向 14nm、7nm、5nm、3nm、2nm 等先进制程节点迭代升级是行业大势，而制程节点越先进，生产工序堆叠越繁杂、工艺结构精度要求越高，对应的产线良率爬坡难度更大、周期也更漫长，工艺迭代与良率优化衍生的材料分析、失效分析呈倍数级持续增长。二是先进制程所需的 FIB、TEM 等高端微观分析设备技术壁垒高、品类丰富且专用性强，综合投入与运维成本极高，出于资产投入效率及自身检测需求存在阶段性波动，晶圆厂一般不会全面配齐所有高端检测设备和可覆盖全部检测需求的配套产能。因此，第三方实验室可通过配套全套高端检测设备、在晶圆厂区周边设立实验室的方式，与晶圆厂内部检测体系形成有效互补，高效响应产线工艺优化与良率提升的检测需求。先进制程持续推进背景下，行业将逐步形成晶圆厂自建基础实验室搭配第三方实验室协同配套的格局，如全球头部晶圆厂台积电亦将高端材料表征、工艺缺陷及良率分析等实验室检测工作委托给宜特等第三方实验室。三是先进制程工艺数据、良率分析结果属于晶圆厂核心涉密工艺资产，出于供应链安全与数据合规管控考量，国内晶圆厂更加倾向选择合规可控、服务响应更快的本土第三方实验室。

③其他半导体产业链企业

半导体设备厂商、半导体材料厂商、封测企业等产业链主体同样存在第三方实验室检测需求。当前全球半导体行业技术竞争持续加剧，叠加国际贸易摩擦、海外对华半导体领域出口管制等外部因素，国内持续加快半导体设备与关键材料自主化发展步伐，如新凯来、北方华创、中微公司、拓荆科技、屹唐半导体、盛美上海等设备企业持续开展高端前道设备研发迭代，设备研发环节衍生出大量专业检测需求，主要集中在两大场景：一方面，设备试制过程中会产生各类失效样品，需通过失效分析定位设备结构、工艺、性能缺陷，为设备制造工艺优化提供依据；另一方面，新设备样机落地后，需对其加工制备的试流片晶圆开展内部结构、材料特性与电性性能表征，校验设备工艺精度与核心参数是否达标。整体来看，随着国内高端半导体设备研发节奏加快、机型迭代增多，设备端对应的检测需求持续扩容，且高端前端设备验证场景技术难度高、分析维度复杂，对第三方实验室的精密检测与复杂问题解析能力提出更高要求。

2、分析客户自建实验室是否会对发行人订单的持续性 & 经营业绩产生重大不利影响，是否存在经营业绩不及预期的风险，进一步完善招股说明书相关风险提示的内容

（1）客户自建实验室不会对发行人订单的持续性 & 经营业绩产生重大不利影响

①自建实验室难以全面替代第三方实验室，第三方实验室具备长期稳定的市场地位

第三方实验室具有集约化成本优势、全品类综合分析能力、独立中立属性，在实验室检测分析市场中将长期存在并占据重要地位。其一，得益于半导体产业垂直分工模式、终端应用场景的碎片化等因素，数量庞大的中小型 Fabless 公司将长期占据市场重要地位，它们普遍无力承担自建实验室的重资产投入，对失效分析、材料分析等专业服务形成了持续且稳定的外包需求，构成了第三方实验室检测分析业务的“压舱石”。其二，在晶圆制造环节，为平衡时效与成本，第三方实验室正以“卫星实验室”模式向晶圆厂周边聚集，通过地理邻近性承接其溢出的常规分析需求，如全球头部晶圆厂台积电将高端材料表征、工艺缺陷及良率分析等实验室检测分析工作委托给宜特等第三方实验室。其三，随着先进制程、

先进封装、车规级芯片、Chiplet 等新应用与新技术的涌现，对超高精度材料分析、复杂失效定位以及 AEC-Q 等权威可靠性认证的需求显著增加，推动头部第三方实验室向高端化、专业化方向持续升级，其产业基础设施的属性愈发清晰。

从半导体产业发展态势来看，第三方实验室与自建实验室长期共存、相互补充将是未来的主要趋势。在能力维度上，两者呈现“自建做专、第三方做全”的分工——企业自建实验室聚焦于高频使用的核心能力（如晶圆厂的在线监控、设计公司的先期电性分析），而第三方则凭借庞大的设备矩阵和跨行业经验，提供材料分析、疑难杂症会诊等“大而全”的深度服务。在时效维度上，则形成“自建保急、第三方保稳”的梯度配合——产线异常等紧急需求由内部实验室快速响应，而周期性、长周期的可靠性验证及批量分析则由第三方承接。这种分层协同使得企业既能守住核心安全与响应速度的底线，又能借助第三方的规模效应和权威背书，实现检测能力的广度延伸与成本优化。

总体而言，依托重资产投入门槛、跨领域技术积累、独立中立性及产业集约化优势，第三方实验室具备不可替代的市场价值，市场份额不会被自建实验室大幅侵蚀，市场需求具备持续成长性。半导体产业链检测环节将长期维持自建实验室与第三方实验室分工协同的格局，客户自建实验室主要用于满足内部核心、紧急检测需求，并不会全面替代第三方实验室。

②从发行人主要客户情况来看，自建实验室的客户仍然采购第三方服务

从发行人自身来看，报告期内，发行人第三方实验室检测分析服务前五大客户中，仅客户 A、客户 F 暂时没有自建实验室，其他客户虽然均已自建实验室，但也同时向发行人等第三方实验室采购检测分析服务。即便报告期内发行人存在个别已自建实验室的客户减少向发行人采购的情形，并不意味着该客户检测需求实现完全自给；其检测需求仍无法完全依靠其自建实验室满足，需要持续向第三方检测机构采购检测分析服务。

综上，客户自建实验室并不会全面替代第三方实验室，并且目前发行人第三方实验室检测分析服务前五大客户仅两家暂时没有自建实验室，其他客户均在已有自建实验室的同时向发行人等第三方实验室采购检测分析服务。因此，客户自建实验室不会对发行人订单的持续性及经营业绩产生重大不利影响。

(2) 是否存在经营业绩不及预期的风险，进一步完善招股说明书相关风险提示的内容

尽管结合行业发展态势及发行人自身经营情况判断，客户自建实验室不会对发行人订单的持续性 & 经营业绩产生重大不利影响，但客户自建实验室仍可能对发行人订单及经营业绩造成短期扰动。发行人已在招股说明书之“第三节/二/(三) 客户自建实验室的风险”补充相关风险提示的内容：

“(三) 客户自建实验室的风险

发行人第三方实验室检测分析业务客户覆盖芯片设计、晶圆制造、封装测试、半导体设备等半导体产业链主体。其中，芯片设计环节仅头部企业自建实验室，多数芯片设计企业实验室检测分析需求以委托第三方实验室为主；晶圆制造、半导体设备厂商出于技术保密、高时效检测分析需求，部分已配套自建实验室，但受自建实验室产能规模有限、复杂疑难问题处理能力不足等约束，仍会将部分检测分析需求委托第三方实验室实施。

若下游客户后续新建实验室或扩建现有实验室规模，更多实验室检测分析需求由内部实验室承接，将减少对发行人的采购需求与订单，从而对公司经营业绩及盈利能力产生不利影响。”

二、中介机构核查情况

(一) 核查程序

1、取得并查阅半导体行业研究报告及统计数据，了解发行人报告期内业绩快速增长的主要驱动因素，取得并分析发行人收入成本大表、各地实验室开业时间及报告期业绩情况，了解发行人报告期内经营业绩与下游半导体行业景气度之间的关系、下游行业进入下行周期对发行人业务稳定性的具体影响；

2、取得发行人第三方实验室检测分析业务的在手订单及期后执行情况，取得并查阅发行人第三方实验室检测分析业务收入、主要客户情况，了解下游半导体产业链对第三方实验室检测分析服务的需求变动情况，了解客户自建实验室对发行人订单的持续性 & 经营业绩的影响。

（二）核查意见

经核查，保荐人认为：

1、全球及中国境内半导体行业具备周期波动特征，当前均处于由 AI 算力驱动的上行周期。报告期内发行人业绩快速增长，系全球及中国境内半导体产业发展，叠加公司客户拓展、多地实验室产能释放、一站式业务体系完善等内外部因素共同驱动。公司业绩与下游行业景气度存在相关性，但并非简单线性同步，第三方实验室检测分析、集成电路测试板业务以客户研发验证需求为核心，呈现一定弱周期性特征。若行业进入下行周期，发行人不同业务板块将呈现结构性分化影响，依托多元化客户结构、多区域实验室布局及一站式综合业务体系，公司具备良好的周期对冲能力，具备较强的稳定性与成长性。

2、结合发行人期后在手订单执行及客户需求变动情况，客户自建实验室不会对发行人订单的持续性 & 经营业绩产生重大不利影响，但客户自建实验室仍可能对发行人订单及经营业绩造成短期扰动，发行人已完善招股说明书相关风险提示。

（本页无正文，为《关于上海季丰电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的审核中心意见落实函的回复》之签章页）

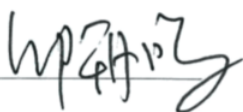
上海季丰电子股份有限公司



发行人董事长声明

本人已认真阅读《关于上海季丰电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的审核中心意见落实函的回复》的全部内容，确认回复内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担相应法律责任。

董事长：



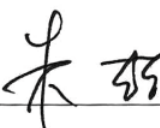
郑朝晖

上海季丰电子股份有限公司



(本页无正文，为《光大证券股份有限公司关于上海季丰电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的审核中心意见落实函的回复》之签章页)

保荐代表人：



朱 喆



谈钟灵



光大证券股份有限公司

2026 年 10 月 8 日

保荐人法定代表人声明

本人已认真阅读《关于上海季丰电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的审核中心意见落实函的回复》的全部内容，了解本回复涉及问题的核查过程、本公司的内核和风险控制流程，确认本公司按照勤勉尽责原则履行核查程序，本回复不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对上述文件的真实性、准确性、完整性、及时性承担相应法律责任。

保荐人法定代表人：



赵陵（代）



光大证券股份有限公司

2026 年 10 月 8 日